

## 2026학년도 반도체 부트캠프 사업 신규 참여학생 모집

한경국립대학교 재학생 중 「2026학년도 반도체 부트캠프사업」을 통해 실시하는 반도체 분야(교과형 및 몰입형) 소단위 전공과정 초·중급 신규 교육생(사업 참여학생)을 다음과 같이 모집하오니, 많은 관심과 참여 바랍니다.

### 1. 2026. 2. 25. 현재 참여학생 현황

구 분	2026년 교육인원	2026. 2. 25. 현재 모집완료	미달인원	비 고
초 급	50	25	25	
중 급	90	69	21	
고 급	10	-	-	2026년 12월 중 중급 이수자 대상 모집 예정

### 2. 모집인원 및 대상

가. 초급: 모집인원 34명 / 3학년 재학생 「참여학부(전공) 재학생」

나. 중급: 모집인원 21명 / 4학년 재학생 「참여학부(전공) 재학생」

다. 참여학부: 전자전기공학부(전자공학전공, 전기공학전공), ICT로봇기계공학부(ICT로봇공학전공, 기계공학전공), 화학공학전공, AI반도체융합전공, 반도체융합전공

※ 참여 신청 인원이 미달인원을 초과할 경우 사업단 선발 기준에 따라 최종 참여 학생 선정(2026. 2. 25. 모집 완료한 인원은 모두 선정하고 평가에서 제외)

### 2. 수혜내용

- 초급 과정 이수자는 2027년도 중급 과정 신청 시 우선 선발 혜택 제공

- 중급 과정 이수자에게는 부트캠프 사업 이수증 수여 및 장학금 지급(최대 150만원\*)

\* 부트캠프사업 참여에 따라 부트캠프마일리지 적립. 적립된 마일리지에 따라 추후 장학금 차등 지급 예정

(수혜학생 선발 후 졸업유예, 휴학, 군입대 등으로 인해 중도 취소하는 경우 혜택 없음.)

### 3. 제출서류

#### 가. 초급

- 붙임1. 첨단산업 인재양성 부트캠프사업 참여신청서
- 붙임2. 첨단산업 인재양성 부트캠프사업 참여의사 확인서
- 붙임3. 개인정보이용동의서(학번\_성명)

#### 나. 중급

- 붙임1. 첨단산업 인재양성 부트캠프사업 참여신청서
- 붙임2. 첨단산업 인재양성 부트캠프사업 참여의사 확인서

- 붙임3. 개인정보이용동의서(학번\_성명)
- 붙임4. 소단위 전공과정 이수 신청서(학번\_성명)

4. 신청 및 선발일정

가. 신청기간: ~ 2026. 2. 27.(금) 12:00까지

나. 최종 참여학생 안내: 2026. 3월 초

5. 제출처: 각 전공 사무실

6. 교육과정

등급	형태	마이크로디그리(소단위 전공) 명칭						
		반도체 소재	반도체 부품/장비		반도체 공정	반도체설계		
반도체 산업의 가치 사슬		③재료	⑦장비 설계			①공정 (8공정)	④설계	
참여전공명		화학공학 전공	ICT로봇 공학전공	기계공학 전공	전기공학 전공	전자공학 전공	반도체융합 전공	AI반도체 융합전공
초급 (기초 공통)	교과형	반도체디스플레이물리전자, 집적회로기초						
	몰입형	반도체공학개론(이공계), 반도체 입문(비이공계)						
중급 (전공 심화)	교과형	반도체및 에너지소자공학	기계학습 AI로봇시스템	-	전력시스템AI 설계및실습	반도체공정 공학 I 반도체공정 공학 II	반도체융합설계 디지털집적 회로설계	반도체 설계실무 집적회로설계 차세대 반도체기술
	몰입형	첨단소재디자인및전산응용 반도체및 기기분석	반도체패키징	공정데이터분석및설계 공정이상진단 및설계 지능형자동화 설계공학	스위칭전원 장치설계 반도체장비 VR실습	반도체 종합공정공학	아날로그 집적회로설계	-
※자율지표		산업의료원						
고급 (전공 심화)	교과형	반도체 소자 특론			고급 집적회로 설계			
	몰입형	반도체 박막 물성학		반도체 공정 심화		반도체 신뢰성 및 분석 기술		